

2

Egz. SŁUŻBOWY

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWAURZĄD
PATENTOWY
PRL

OPIS PATENTOWY

66176

Patent dodatkowy
do patentu _____

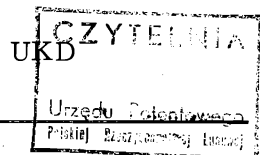
Kl. 21c,7/04

Zgłoszono: 20.I.1970 (P 138 275)

Pierwszeństwo: _____

MKP H02g 1/12

Opublikowano: 15.VIII.1972



Twórca wynalazku: Grzegorz Kasperkiewicz

Właściciel patentu: Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników
(Instytut Technologii Elektronowej), Warszawa
(Polska)Sposób usuwania emalii z przewodów miedzianych, emaliowanych,
z jednoczesnym ich cynowaniem

1

Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania emalii z przewodów miedzianych, emaliowanych, z jednoczesnym ich cynowaniem. Wynalazek jest szczególnie użyteczny przy cynowaniu przewodów o małych i bardzo małych średnicach, jedno- lub wielożyłowych.

Znane są sposoby usuwania emalii z przewodów miedzianych polegające na mechanicznym jej usuwaniu, najczęściej ostrymi narzędziami.

Znane są także sposoby polegające na opalaniu emalii otwartym płomieniem, bądź podgrzewaniu jej do określonej temperatury i zanurzeniu w alkoholu.

Znane sposoby były wszakże niedogodne w zastosowaniu szczególnie do przewodów o małych i bardzo małych średnicach. Usuwanie emalii z takich przewodów znanymi sposobami powodowało dość często albo mechaniczne ich uszkodzenie (przecinanie, zrywanie) albo upalenie połączone z nadmiernym utlenieniem pozostałego odcinka przewodu.

Celem wynalazku jest uniknięcie opisanych wad, a zagadnieniem technicznym opracowanie dogodnego sposobu usuwania emalii z przewodów miedzianych o małych i bardzo małych średnicach, przeznaczonych do ocynowania.

Wytoczony cel osiągnięty został według wynalazku dzięki temu, że przewód układa się na podłożu z tworzywa termoplastycznego, po czym pokrywa się go mieszaniną kwasu salicylowego

2

z kalafonią, a następnie tak przygotowany przewód ogrzewa się przez nałożenie nań roztopionego lutownia cynowego.

Bliższe objaśnienie istoty wynalazku podano poniżej.

Jak już wspomniano, proces usuwania emalii następuje jednocześnie z procesem cynowania przewodu. Przygotowany przewód układa się na podłożu z tworzywa termoplastycznego, po czym pokrywa się go mieszaniną kwasu salicylowego z kalafonią. Zawartość kwasu salicylowego w mieszaninie wynosi od 10 do 60%. Na tak potraktowany przewód nakłada się następnie roztopione lutownia cynowe, na przykład za pomocą lutownicy. Zastosowanie w sposobie według wynalazku podłoża z tworzywa termoplastycznego powoduje, że pod wpływem temperatury roztopionego lutownia tworzywo mięknie, umożliwiając osadzenie się przewodu w wytworzonej w podłożu bruzdzie. Zapobiega to skutecznie ewentualności urwania cynowanego odcinka przewodu. Przypomnieć bowiem wypada, że sposób według wynalazku jest szczególnie użyteczny przy usuwaniu emalii i cynowaniu przewodów o małych i bardzo małych średnicach, rzędu poniżej 0,2 mm.

Sposób według wynalazku nie wywołuje dodatkowego utleniania miedzi, ani też nie wprowadza zanieczyszczeń powierzchniowych przed nałożeniem lutownia. Połączenie operacji usuwania emalii z jednoczesnym pokrywaniem lutowniem niewątpli-

wie upraszcza proces produkcyjny. Wymienione zalety stanowią, że sposób według wynalazku stanowi osiągnięcie celu wytyczonego dla twórczego rozwiązania.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób usuwania emalii z przewodów miedzianych, emaliowanych, z jednoczesnym ich cynowaniem, w szczególności przewodów o małych

i bardzo małych średnicach, **znamienny tym**, że przewód układa się na podłożu z tworzywa termoplastycznego, po czym pokrywa się go mieszaniną kwasu salicylowego z kalafonią, a następnie tak przygotowany przewód ogrzewa się przez nałożenie nań roztopionego lutownia cynowego.

2. Sposób według zastrz. 1, **znamienny tym**, że jako mieszaninę do pokrywania przewodu stosuje się mieszaninę zawierającą od 10 do 60% kwasu salicylowego.